****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*congatec provides full support of new Computer-on-Module specifications COM Express 3.0, Qseven 2.1 and SMARC 2.0*

*Text and photo available at:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**Communiqué de presse**

**congatec présente sa roadmap SMARC 2.0, Qseven 2.1
et COM Express 3.0**

**congatec prend totalement en charge les nouvelles spécifications
Computer-on-Module SGET et PICMG.**

Paris -- 23 février 2016 -- congatec, acteur de premier plan dans le domaine des modules processeurs embarqués, des cartes SBC et des services EDM, annonce à l'Embedded World qu'elle prend totalement en charge les prochaines spécifications Computer-on-Module SGET et PICMG SMARC 2.0, Qseven 2.1 et COM Express 3.0. Des modules conformes à ces standards sont d'ores et déjà en développement et seront annoncés en même temps que les prochaines générations de processeurs.

**Roadmap SMARC et Qseven**

congatec prendra totalement en charge la spécification SMARC 2.0. Les modules SMARC 2.0 seront disponibles pour toutes les gammes de processeurs, allant du processeur Intel Atom aux différents modèles ARM.

La différence essentielle entre les deux standards est le nombre d'interfaces prises en charge avec Qseven (jusqu'à 230 broches) et SMARC 2.0 (jusqu'à 314 broches). SMARC est destiné à interfacer avec des systèmes plus riches mais également plus petits alors que Qseven est idéal pour des modules & leur carrier card plus fins et moins complexes.

congatec a joué un rôle significatif et actif dans le développement de tous les standards. Pour les spécifications Qseven et SMARC, congatec a même assumé le rôle de rédacteur et par conséquence est un fournisseur technologique clé pour les design SFF très compacts équipés de Computer-on-Modules, marché où congatec est devenu leader.

Christian Eder, directeur du marketing chez congatec, membre du comité SGET et rédacteur de la spec SMARC, déclare : "En passant de SMARC 1.1 à 2.0, nous avons réussi à donner à ce standard un avenir clair. Cette étape cruciale a apporté de nombreuses nouvelles interfaces et éliminé beaucoup de fonctions obsolètes. Alors que les designs en SMARC 1.1 ne seront peut-être plus compatibles avec la 2.0, les utilisateurs auront en compensation à leur disposition de nombreuses nouvelles fonctions".

**Roadmap COM Express**

COM Express 3.0 aura un nouveau type de broche pour les Server-on-Modules. Les processeurs Intel® Xeon®et Intel Core axés serveurs ainsi que les processeurs AMD Embedded R-Series sont la première cible avec les plates-formes ARM comme autre option possible.

"Toutes les nouvelles spécifications apportent aux développeurs une prise en charge des nouvelles interfaces et de nombreuses améliorations. Après la nouvelle spec SMARC 2.0 pour les systèmes multi-fonction extrêmement compacts, le nouveau brochage COM Express pour les Server-on-Modules est particulièrement innovant. Il nous permet de cibler de nouveaux marchés pour les serveurs décentralisés en temps réel utilisés dans le media streaming ainsi que les applications IoT, M2M, médicales et d'automatisation", explique Martin Danzer, responsable produits chez congatec.

Grâce au service d'intégration personnalisé de congatec, les développeurs apprécieront la facilité d'intégration des nouvelles révisions dans leurs futurs designs. Puisque la plupart des fonctions sont rétro-compatibles, il est possible dans de nombreux cas de mettre à niveau les cartes porteuses avec les nouveaux modules. Les OEM ont la garantie que leur investissement existant est protégé.

**A propos de Congatec**

Congatec AG, dont le siège est situé à Deggendorf, Allemagne, est un fournisseur de premier plan de modules processeurs industriels utilisant les standards Qseven, COM Express, XTX et ETX, de cartes SBC et de services EDM. Les produits de Congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente. Parmi les compétences et le savoir-faire technique de Congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de Congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. La société possède des filiales à Taiwan, au Japon, Chine, USA, Australie et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](file:///C%3A%5CUsers%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CA0UKGA4I%5Cwww.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*

*Intel and Intel Atom, Core, Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*